



# i.MX RT700 Arm® Cortex®-M33、NPU、DSP、GPUコア搭載クロスオーバーMCU

## i.MX-RT700

### Preproduction

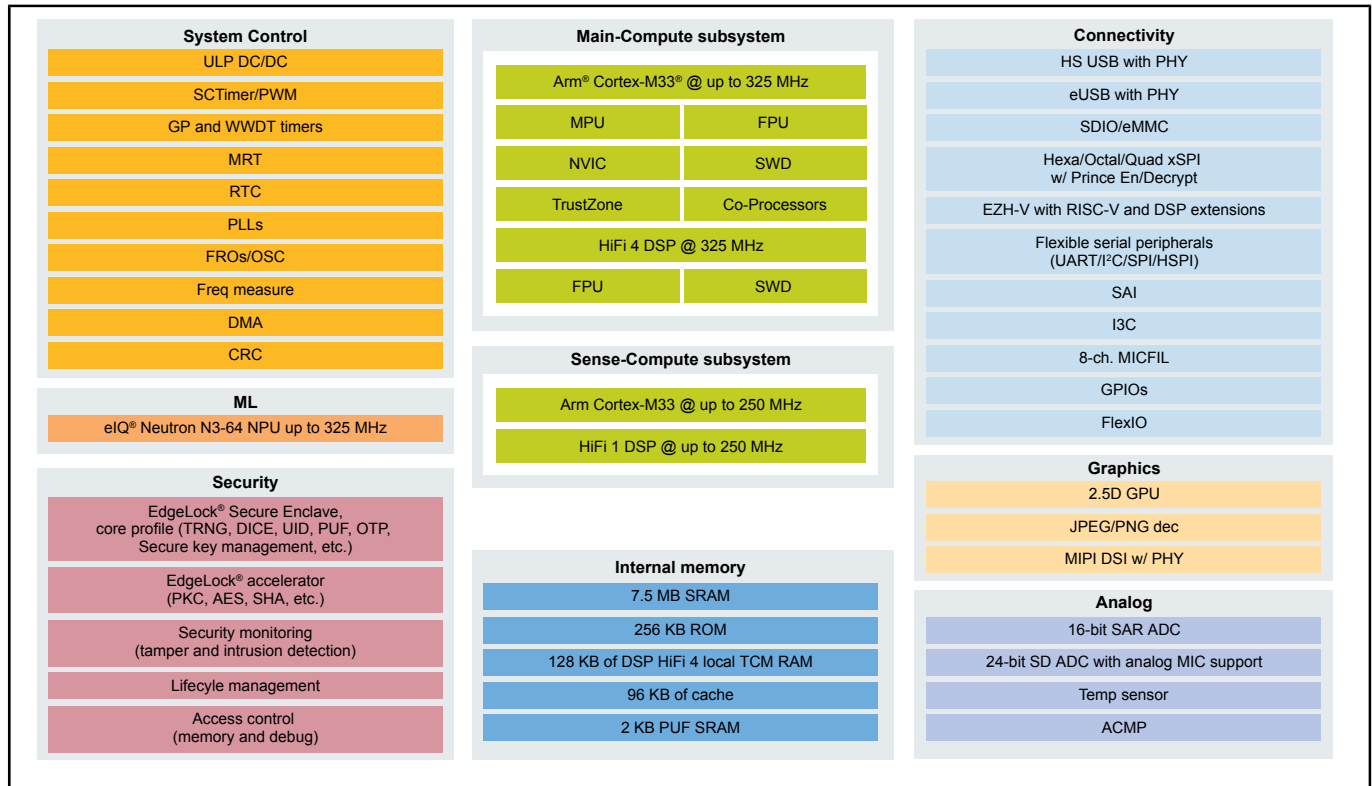
このページでは、試作品の情報を掲載しています。ここに記載されている仕様や情報は、予告なく変更されることがあります。追加情報については、または営業担当者にお問い合わせください。

Last Updated: Sep 27, 2024

i.MX RT700は、ウェアラブル、民生用医療機器、スマートホーム・デバイス、HMIデバイスなどのAI対応スマート・エッジ・デバイスを駆動するように設計された、最大5つの演算コアを備えています。コンピュータ・サブシステムには、325 MHzで動作するプライマリArm® Cortex®-M33と、DSPおよびオーディオ処理を強化するCadence® Tensilica® HiFi 4 DSPが搭載されています。超低消費電力のセンス・サブシステムには、2つ目のArm Cortex-M33およびCadence Tensilica HiFi 1 DSPが搭載されています。これにより外部センサ・ハブが不要になり、システム設計の複雑さ、フットプリント、および部品コストを低減できます。また、i.MX RT700は、AIワークロードを最大172倍高速化するNXPのeIQ® Neutron NPU、および最大7.5 MBのオンボードSRAMを内蔵しています。

i.MX RT700は、SDK、各種IDE、セキュア・プロビジョニング、構成ツールを含むMCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされており、迅速な開発を可能にします。

## i.MX RT700 クロスオーバーMCU Block Diagram



View additional information for [i.MX RT700 Arm® Cortex®-M33、NPU、DSP、GPUコア搭載クロスオーバーMCU](#).

**Note:** The information on this document is subject to change without notice.

[www.nxp.com](http://www.nxp.com)

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2024 NXP B.V.